

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於 2023 年度利潤分配預案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 3 月 22 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-017

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的发展阶段。

一、利润分配预案基本情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“复旦微电”)2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 719,494,375.58 元,公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 3,200,007,316.38 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 819,060,400 股,以此计算拟派发现金红利合计 81,906,040 元(含税),现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 11.38%。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

末期股息将以人民币计值及宣派，A 股股息将以人民币派付，H 股股息将以港元派付。现金股息由人民币转换至港元所用之汇率将按照宣派股息当日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率的平均中间价。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东周年大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。本公司所处的集成电路设计产业具有技术密集、知识密集、资本密集等特点，业内技术升级与产品迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。报告期内，公司研发投入约为 11.90 亿元，占当年营业收入 33.64%。为保持公司在技术方面的竞争力，公司仍需维持较大规模的研发投入，以支撑产品持续迭代、丰富产品类型进而应对下游客户多样化的需求和应对市场风险，以维持市场竞争力。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。

公司拥有安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。在各产品线内均有相应的国际、国内企业深耕，市场竞争较为激烈。目前公司处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于技术研发以及市场拓展等工作。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司为应对芯片设计行业竞争，需要投入大量资金用于研发投入、扩充团队，开拓市场等。

2024 年，公司资金需求包括但不限于以下方面：

（1）推进包括基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA、智能化可重构 SoC

平台开发在内的新产品，拓展新制程、新封装形式的产品谱系；

(2) 对车规级 MCU、安全识别芯片等产品的研发；

(3) 随着企业规模扩大，日常销售、管理等营运所需资金可能增加；

(4) 用于归还到期的银行贷款等。

(四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，以保持公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇，有利于提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

(二) 监事会意见

2024 年 3 月 22 日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

(二) 其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年3月23日